

環境負荷化学物質含有量

環No.2019-37
2019年4月11日

製品名 : MKY37
部品質量(mg) : 260

株式会社ステップテクニカ 管理部
E-mail kanri_step@steptechnica.com

部位	素材・化学物質	CAS No.	質量 (mg)	部位含有率 (wt%)	全体含有率 (wt%)	使用目的
チップ	シリコン(Si)	7440-21-3	5.5213	98.5803	2.1236	素子材料
	ヒ素(As)	7440-38-2	1.00E-04	0.0011	0.00E+00	ドーパント
	ホウ素(B)	7440-42-8	6.00E-04	0.0098	2.00E-04	ドーパント
	リン(P)	7723-14-0	1.80E-03	0.0318	7.00E-04	ドーパント
	チタン(Ti)	7440-32-6	2.30E-02	0.4101	8.80E-03	回路形成
	タングステン(W)	7440-33-7	5.30E-03	0.0952	2.10E-03	回路形成
	銅(Cu)	7440-50-8	2.00E-04	0.0027	1.00E-04	回路形成
	アルミニウム(AI)	7429-90-5	4.87E-02	0.869	1.87E-02	回路形成
チップマウント	銀(Ag)	7440-22-4	0.4495	77.0012	0.1729	導電性材料
	アクリル樹脂	---	0.1168	19.9993	0.0449	接合材料
	エポキシ樹脂	---	0.0175	2.9995	0.0067	接合材料
リードフレーム	銅(Cu)	7440-50-8	109.0573	97.1404	41.9452	フレーム材料
	鉄(Fe)	7439-89-6	2.5674	2.2868	0.9875	フレーム材料
	銀(Ag)	7440-22-4	0.6431	0.5728	0.2474	銀メッキ
ワイヤ	金(Au)	7440-57-5	1.283	100	0.4935	配線
外部端子メッキ	スズ(Sn)	7440-31-5	8.7338	100	3.3591	端子表面処理材料
パッケージ	エポキシ樹脂	---	18.0197	13.7	6.9305	封止樹脂材料
	有機リン化合物	---	1.3153	1	0.5059	封止樹脂材料
	シリカ(SiO2)	60676-86-0	111.801	85	43.0004	封止樹脂材料
	カーボン(C)	1333-86-4	0.3946	0.3	0.1518	封止樹脂材料
含有量合計			260		100	